

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

立讯精密工业股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：年度股东会交流环节
参与单位名称及人员姓名	公司 2025 年度股东会参会股东
时间	2026 年 5 月 22 日
地点	广东省东莞市清溪镇北环路 313 号
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理王来春女士；董事兼副总经理钱继文先生；董事兼副总经理郝杰先生；独立董事刘中华先生；独立董事宋宇红女士；独立董事侯玲玲女士；财务总监吴天送先生；董事会秘书肖云兮女士；职工代表董事及证券事务代表陈蔚航先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事长、总经理王来春女士与参会股东交流公司经营情况与未来展望</p> <p><b>Q1：公司在 AI 算力领域已布局光连接、铜连接、液冷、电源业务，请问公司对技术路线选择的逻辑和未来发展规划是什么？</b></p> <p>答：公司自 2013 年起即推动传统线缆连接器业务向通信产业拓展；2020 年初开始布局 AI 算力赛道；自 2024 年以来，公司积极开拓海外 CSP 市场，并向客户推介通信产业的成熟产品。过去两年，公司在技术端和商务端均取得较好成果，相关能力得到客户认可。</p> <p>关于光连接和铜连接，公司认为，信号连接的核心原则是越简单越好，成本更低、能耗更低的方案会优先被采用。随着信号传输速率不断提升，光连接可覆盖更远距离、更高速率的传输需求，铜连接的覆盖范围会相应收窄，这是正常趋势。但铜连接需要方案提供商对信号源、线缆、连接器和系统架构进行全方位设计，对系统</p>

架构理解和整合能力的要求更高，因此未来铜连接领域头部供应商的集中度预计会更高，仅少数厂商具备竞争力。

对公司而言，液冷业务当前以打好能力基础为主；在电源业务方面，公司仅介入低压 DC-DC 领域。综合考虑宏观环境和公司自身基础，这两部分业务仍需要更多沉淀，待基础更加成熟后再发力。

**Q2: 公司未布局 PCB 领域，是基于什么考量？**

答：PCB 目前不在公司短期发展计划内。

**Q3: 公司对未来三年 AI 算力领域资本开支景气度的判断如何？**

答：公司认为，全球 AI 算力需求在未来 3 至 5 年内仍将保持强劲增长，但能源短缺会带来一定挑战。公司从通信赛道切入 AI 算力赛道，是因为看到这部分业务未来 3-5 年都会有较好的成长空间，其发展机遇可类比公司 2017 年在消费电子领域所面临的机遇。

**Q4: 公司 800G 光模块已有多少家 CSP 客户完成验证并量产？公司 1.6T 光模块是否具备自研硅光芯片的能力？公司 CPC 铜连接目前处于什么进展？**

答：公司一贯坚持与赛道内优秀的供应链伙伴和客户伙伴紧密合作。作为光模块领域的新进入者，公司面对的是多家历史悠久、能力成熟的同业企业，短期仍面临诸多挑战；商务层面和营收规模的拓展仍需要时间。公司目前暂不具备自研 1.6T 硅光芯片的能力。在 448G CPC 铜连接技术领域，公司已处于行业领先水平，业务进度符合预期。

**Q5: 公司在 AI 眼镜领域有什么在手订单以及进展情况如何？公司对 AI 手机未来需求预期判断如何？**

答：目前，端侧 AI 产品尚未形成达到百万级、千万级出货规模的消费者刚需产品。AI 眼镜仅在部分细分场景，如提词器、翻译工具、投屏显示等方面具备应用价值，尚未成为工作和生活的刚需。公司会紧跟行业发展步伐，保持技术领先。对于 AI 手机，公司认为，其核心壁垒不在于硬件实现，而在于生态建设以及对各地区政策法规环境的适配。作为硬件制造厂商，公司需要识别未来有能力创造颠覆性产品的客户，并与其保持紧密合作。

**Q6: 请问公司未来对于主要客户与供应商依赖度的指引如何？**

答：公司的能力、团队的敬业精神和专业基础，都来自核心大客户的长期培养。正是基于大客户核心供应商的背景，公司才能顺利拓展其他消费电子客户，以及汽车、通信、AI 算力等跨领域业务。公司认为，依托核心大客户发展是时代赋予公司的机遇，并非错误选择。公司在集中资源服务核心大客户的同时，也一直在培养自身的横向拓展能力。过去三年，公司在其他领域已经取得明显发展，即便今年一季度市场面临多重挑战，公司整体依然保持了足够强的韧性。

**Q7: 存储芯片涨价是否给公司带来经营的压力？**

答：ODM/JDM 厂商通常不直接承担存储、显示屏、电池、CPU 等核心零部件价格波动带来的成本风险，因此，存储芯片涨价本身并未给公司带来额外成本压力。

**Q8: 立讯可以成功的核心特质是什么？公司在三大业务板块之外，是否探索新领域？**

答：公司的核心原动力来自企业文化。立讯始终坚持“使命必达”，重视服务精神与内部协作，减少组织内耗，并打造了一支具备工匠精神、持续学习能力的稳定核心团队。公司核心决策层始终扎根市场与客户一线、业务团队一线和工厂一线。只有长期在一线工作，才能更合理地调配团队资源。目前，管理层对公司未来十年在三大核心赛道的发展蓝图非常清晰，后续根据行业趋势变化，会有部分微调的空间。对于新领域的探索，以人形机器人为例，公司会持续关注、学习并谨慎投入。公司认为，长期来看，全球或存在大量机器人需求，但大规模需求到来的时间尚不明确。此外，作为 AI 算力供应链企业，公司正在快速引入 AI 平台，通过 AI 提升自身管理与制造环节的效率，在争取商业机会的同时，推进内部各项运作效能提升。

**Q9: 请问公司未来是否考虑整车 OEM 业务？在汽车板块未来的规划是什么？**

答：公司不考虑整车组装业务。公司汽车板块当前的经营重点，是为中国车企出海提供 Tier 1 全球制造配套服务，同时为海外汽车

品牌提供全球配套资源。目前，立讯是中国 Tier 1 供应商中全球服务布局较为完整的企业之一；同时，公司在 Leoni 方面的布局也已被验证为正确，并已取得较好成果，我们相信京西的布局也会像 Leoni 一样，发挥其价值。

**Q10：公司在低轨通信卫星与人形机器人领域，立讯可以做好哪些细分环节，自身优势是什么？**

答：在人形机器人领域，当前行业最需要的是机器人专用标准零部件。立讯常熟工厂已具备相关能力，可以配合核心客户同步开发这类专用零部件，不必完全沿用工业或汽车领域的现有零部件。作为大规模制造企业，公司拥有丰富的应用场景，可与行业共同成长；但在行业尚不成熟时，公司不会进行大规模投入。目前，全球机器人行业缺乏统一法规与行业标准。未来具备较大市场需求的机器人，预计会首先出现在安全风险较低、容错空间相对较大的室内商业场景，并逐步培育市场。此外，对立讯内部而言，公司可将机器人相关功能拆解后应用到自身智能制造环节，减少无功工站和无功工时的投入。

商业航天业务方面，立讯目前已供应部分部件，但规模不大；海外客户普遍对地缘政治因素较为敏感，产业规模化仍需要一定时间。

**Q11：公司在 CPC 领域 448G 已做到领先，是否会继续研发 896G 或更高速率产品？448G 是否已经达到物理瓶颈？**

答：从物理极限来看，896G 铜连接仍存在较大挑战，目前行业尚未找到明确的突破方案。行业专家判断，448G 铜连接可以满足至 2030 年前后的需求。

**Q12：通信数据通信业务营收增长 30%但毛利率仅提升 2%，是否说明光模块当前对业绩贡献有限？**

答：通信与数据中心新孵化的业务前置投入较大，超过了这些业务当前能带来的贡献。此类为布局未来市场而进行的提前投入，短期内拉低了整体毛利率。若剔除提前投入因素，公司盈利能力表现良好，整体利润率不逊于同行。

**Q13：立讯主张光铜并进，但头部客户英伟达大量布局光芯片、**

	<p><b>光纤厂商，是否存在矛盾，如何看待光铜路线的发展？</b></p> <p>答：在公司当前服务的产品中，我们看到未来光连接的需求规模会远大于铜连接，但铜连接的技术门槛同样很高。两者并非简单替代关系，而是会长期共存：短距离场景适用铜连接，长距离及更高速率场景对光连接的需求更大；当铜连接接近信号传输极限时，需要通过光连接解决问题。因此，光铜并进与头部客户布局光芯片、光纤厂商并不矛盾。</p> <p><b>Q14：如何看待创新试错中的失败，如何维持团队士气？</b></p> <p>答：不能仅用商业化结果来定义失败。立讯的企业文化中包含容错机制：只要决策是共同做出的，团队也已竭尽全力，即便商业化结果不佳，过程中沉淀下来的技术与经验，对公司未来发展也都是有价值的。没有容错空间，就很难产生创新成果。因此，公司不会因担心犯错而停止或回避创新投入。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026年5月22日